

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2021-047

通富微电子股份有限公司

关于增加公司 2021 年为下属控制企业提供担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日、2021 年 4 月 28 日分别召开了第七届董事会第三次会议、2020 年度股东大会，审议通过了《公司及下属控制企业 2021 年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为下属控制企业 TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD（以下简称“通富超威槟城”）提供担保不超过 1 亿美元，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。

目前，通富超威槟城生产需求旺盛，为进一步满足市场客户需求，拟增加融资，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年为下属控制企业提供担保计划的议案》，同意公司为通富超威槟城提供担保的额度由不超过 1 亿美元调整为不超过 2 亿美元，根据相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟增加担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD	85%	54.84%	18,088.28 万元	1 亿美元	6.53%	否

三、被担保人基本情况

TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.

成立日期：1978 年 8 月 3 日

注册地点：No. 368-3-1 & 2 Bellisa Row Jalan Burma Georgetown Pulau Pinang

法定代表人：石磊

注册资本：1, 570, 000 马来西亚林吉特

主营业务：半导体集成电路的封装与测试

通富超威槟城为公司的下属控制企业，公司间接持股 85%；AMD 间接持股 15%。

通富超威槟城主要财务数据：

单位：万元

	通富超威槟城	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	229, 297. 57	249, 882. 18
负债总额	116, 905. 81	137, 025. 17
流动负债总额	104, 229. 03	128, 366. 86
净资产	112, 391. 76	112, 857. 01
	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	285, 073. 47	166, 981. 46
利润总额	13, 021. 81	4, 181. 32
净利润	12, 405. 49	4, 756. 35

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年半年度财务数据未经审计。

通富超威槟城为公司下属控制企业，具有较好的资产质量和资信状况，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将根据通富超威槟城实际需要签署担保合同及相关法律文件。

五、董事会意见

公司本次增加通富超威槟城的担保额度，有助于满足通富超威槟城生产经营资金需要，促进其业务发展；通富超威槟城财务风险可控，具有实际债务偿还能力；本次增加担保额度符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

按照美元兑人民币汇率 1: 6.4601 计算, 截至目前, 公司实际担保总额 260,865.89 万元, 占公司 2021 年 6 月 30 日归属于母公司股东净资产的 26.36%。

本次新增担保计划总额 64,601.00 万元, 占公司 2021 年 6 月 30 日归属于母公司股东净资产的 6.53%。公司实际担保总额加本次新增担保计划总额共计 325,466.89 万元, 占公司 2021 年 6 月 30 日归属于母公司股东净资产的 32.88%。公司及下属控制企业无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议。

通富微电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日